

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2017-024

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司关于 控股子公司海太半导体 2017 年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 控股子公司海太半导体（无锡）有限公司 2017 年计划以自有资金新增投资 9390 万美元用以技术升级和扩张产能；
- 本年度投资计划为公司及子公司对 2017 年度投资的预算安排，在具体实施过程中，受市场需求、政策变动或产品价格调整等因素影响可能会相应调整投资计划；

一、海太半导体 2017 年投资计划概述

2017 年，公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太半导体”）拟使用运营现金流中的可用资金 9390 万美元进行技术升级和产能扩张，以提高为 SK 海力士提供后工序服务的配套能力。投资的顺利实施有利于海太半导体扩大生产规模，提高设备产能，调整现有产品结构，保持公司世界先进的领先地位。投资完成后封装、封装测试及模组测试能力将进一步提升，预计封装业务、封装测试、模组测试产量较 2016 年分别提高 31%、23%、47%（1Gb 基准）。

本公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司海太半导体 2017 年度投资计划的议案》，本议案无需提交股东大会审议。海太半导体 2017 年投资计划不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

海太半导体（无锡）有限公司成立于 2009 年 11 月，由公司与 SK 海力士株式会社（以下简称“海力士”）共同出资组建，注册资本为 17,500 万美元，实收资本为 17,500 万美元，法定代表人为孙鸿伟，住所为无锡市新区出口加工区 K5、K6 地块，经营范围为：半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装

配和模块测试、自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。营业期限为 2009 年 11 月 10 日至 2029 年 11 月 9 日。海太半导体截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 3,084,560,584.19 元；净资产 1,576,461,959.89 元；营业收入 3,242,383,218.76 元；净利润 217,659,302.55 元（已审计）。截至 2016 年 12 月 31 日，海太半导体股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
无锡市太极实业股份有限公司	9,625	55%
SK 海力士株式会社	7,875	45%
合计	17,500	100%

三、投资标的基本情况

根据海太半导体与海力士于 2015 年 4 月 29 日签署的《第二期后工序服务合同》（该合同已经经公司七届十八次董事会及 2014 年年度股东大会审议通过）的约定：在合同期限内，SK 海力士有要求时，受限于部分条件，海太半导体应当使用海太半导体的运营现金流中的可用资金作为资本性支出，以便为 SK 海力士提供后工序服务。

2017 年，海太半导体拟使用运营现金流中的可用资金 9390 万美元进行技术升级和产能扩张，以提高为 SK 海力士提供后工序服务的配套能力。项目建设期为 1 年。本次投资包括购置封装、模组等设备、购置测试系统、建立测试平台、更新部分检测设备及增加 DD4 检测设备等，投资的顺利实施有利于海太半导体扩大生产规模，提高设备产能，调整现有产品结构，保持公司世界先进的领先地位。投资完成后封装、封装测试及模组测试能力将进一步提升，预计封装业务、封装测试、模组测试产量较 2016 年分别提高 31%、23%、47%（1Gb 基准）。

四、对外投资合同的主要内容

不适用

五、新增投资对上市公司的影响

海太半导体 2017 年新增投资项目有利于其扩大生产规模，提高设备产能，调整现有产品结构，保持封装模组测试加工行业国际领先水平，新增投资项目遵循了签署的相关协议，符合公司和股东的利益。

六、对外投资的风险分析

海太半导体 2017 年投资计划在具体实施过程中，受市场需求、产品价格和客户经营状况等多种因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日